



连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板接头和插座



PCB 连接器组件类型: **PCB 安装接头**

PCB 安装方向: **直角**

连接器系统: **板对板**

Number of Positions: **3**

中心线（间距）: **2.54 mm [.1 in]**

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头
连接器系统	板对板
接头类型	分离
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	直角
Number of Positions	3
板对板配置	Perpendicular

接触件特性

端子接触部电镀材料	金
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

接合对准	不带
PCB 安装固定	不带



PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	PCT GV

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
------------	------------------

使用环境

工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Box & Carton
------	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



文档

产品图纸

MOD2 ST-LEIS90 3P

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_1241891-3_A2.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1241891-3_A2.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1241891-3_A2.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPMODU Interconnetion System

AMPMODU Interconnetion System

英文版本